

TECA 電子連接產業升級研討會

全方位連接器電鍍技術：製程優化與品質管控實務

| | |
|-------------|--|
| 時間 | 2026年07月24日(星期五) |
| 主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 |
| 地點 | 新竹工研院-新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 |
| 大綱 | 由基本電化學原理做起點，了解連接器電鍍製程之樣貌，同時透過製程探討，檢視未來連接器電鍍製程之發展趨勢 |
| 適合聽課對象 | 電鍍製程相關從業人員或對電化學製程有興趣之相關人士 |
| 預期效益 | 現場工程師可以建立對電鍍製程之掌握能力，品管人員可以找出影響品質要素，管理人員可以藉本課程探索未來發展方向 |
| 講師 | 李博士 (現職：工研院材化所先進金屬與複合材料研究組副組長，經歷：1. 精微成型與表面技術研究室經理、2. 精微成型與表面技術研究室資深研究員、3. 精微成型與表面技術研究室研究員，專長：電化學、熱電材料、膠體與界面科學)。 |
| 09：20-10：40 | 電鍍製程中常用之電化學原理 |
| 10：50-12：10 | 連接器電鍍製程介紹與分析 I |
| 12：10-13：10 | 午餐時間 |
| 13：10-14：30 | 連接器電鍍製程介紹與分析 II |
| 14：40-16：20 | 電鍍技術之未來發展 |

★費用：<AI聯盟會員免費2名> 會員NT\$3,800元/人；非會員NT\$7,500元/人

第2位以上報名→半價 (費用含講義/稅，手續費用請自付)

註：1. 欲取消報名需於課程5日前告知，逾時或當日未到課者，恕不退費亦不接受變更其他課用；

2. 課程5日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費，於課程結束後統一退費作業！

★參加辦法：請先傳真報名或線上報名並來電確認

匯款或轉帳，土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會

★聯絡電話：(03)5910002 林小姐，5910003 朱小姐 傳真：(03)5910009

★因颱風…等天災，新竹縣或新竹市政府，宣布停止上班，則當日課程另擇期舉行。

◎台灣電子連接產業協會研討會 報名表◎

| | | | | | |
|---------|--|---|----|------|----|
| 公司全銜 | (發票抬頭： <input type="checkbox"/> 同公司名稱 <input type="checkbox"/> 其他 _____) | | | | |
| 聯絡地址 | | 統一編號 | | 傳真 | |
| E-mail | | 聯絡人 | | 電話 | |
| 參加者姓名 | 職稱/工作部門 | 午餐 | 手機 | mail | 分機 |
| | | <input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷 | | | |
| 費用共計新台幣 | 元整，應支付費用\$_____元，支付方式 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 匯款/轉帳 | | | | |

註：學員之手機號碼僅做為開課未到聯繫用

(表格如不敷使用請自行影印)1150724電鍍應用